

# Влияние концентрации Gd на сверхпроводящие свойства в ВТСП лентах 2-го поколения

**П. Н. Дегтяренко<sup>1)</sup>, А. В. Садаков<sup>1)</sup>, А. В. Овчаров<sup>1)D×</sup>, А. Ю. Дегтяренко<sup>1)D\*</sup>, С. Ю. Гаврилкин\*,  
О. А. Соболевский<sup>1)D\*</sup>, А. Ю. Цветков\*, Б. И. Массалимов<sup>1)D\*</sup>**

+ Объединенный институт высоких температур РАН, 125412 Москва, Россия

\* Центр высокотемпературной сверхпроводимости и квантовых материалов им. В. Л. Гинзбурга ФИАН, 119991 Москва, Россия

× Национальный исследовательский центр “Курчатовский институт”, 123182 Москва, Россия

Поступила в редакцию 24 августа 2023 г.

После переработки 13 сентября 2023 г.

Принята к публикации 13 сентября 2023 г.

В данной работе представлены систематические исследования высокотемпературных сверхпроводящих лент 2-го поколения с избыtkом по Gd относительно стехиометрического состава пленок  $\text{GdBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_7$ . Выявлено, что при росте пленки образуются нитевидные дефекты в виде несверхпроводящей фазы  $\text{Gd}_2\text{CuO}_4$ , расположенные вдоль плоскости  $ab$ . Эти включения приводят к изменению механизма пиннинга вихревой структуры, благодаря чему отчетливо наблюдается пик критического тока при +15 % Gd.

DOI: 10.31857/S1234567823200077, EDN: orhiig

**1. Введение.** За последнее время сверхпроводники (СП) продемонстрировали успешные результаты для крупномасштабного применения в установках ускорительной техники, термоядерной энергетики и медицины [1, 2]. Для достижения высоких и однородных магнитных полей в сверхпроводящих магнитных системах (СМС), критические токи должны быть не менее  $I_c = 1000$  А в собственном поле. Такие результаты получены при разработке СМС на основе низкотемпературных сверхпроводников NbTi и Nb<sub>3</sub>Sn [3]. К успешным применением этих материалов можно отнести создание и модернизации СМС большого адронного коллайдера (БАК) [4, 5] и СМС японского ускорителя J-PARC [6], в термоядерной энергетике разработка и создание токамаков Tore Supra [7] и ITER [8].

Однако для перехода к более высоким значениям магнитных полей необходимо исследовать новые материалы. Одним из таких материалов являются высокотемпературные сверхпроводящие (ВТСП) материалы с измененным составом на основе ReBCO (Re – редкоземельный элемент). Комбинации состава по Re элементу приводят к образованию различных типов дефектов, которые преимущественно определяют сверхпроводящие свойства [9]. Основным преимуществом этих сверхпроводников являются высо-

кие значения критической температуры  $T_c \sim 94$  К и верхнего критического поля  $H_{c2} \sim 100$  Тл [10]. Именно поэтому основным перспективным вариантом использования ВТСП сверхпроводников является производство на их основе ВТСП лент 2-го поколения для крупномасштабного применения [11].

Для использования в прикладных целях необходимо более детальное исследование их сверхпроводящих характеристик [12–14]. Повышение сверхпроводящих параметров, как правило, осуществляется за счет использования таких методов, как: добавление искусственных центров пиннинга (ИЦП) [15, 16], радиационное облучение [17–19] или изменение состава по редкоземельному элементу или его замена [20, 21]. Все они направлены на создание однородного распределения дефектов, которые являются центрами закрепления вихрей Абрикосова [22]. Оптимальная концентрация дефектов позволяет распределяться вихрям таким образом, чтобы в сверхпроводнике образовалась вихревая решетка, способствующая повышению плотности критического тока. Более подробно изученными являются ВТСП ленты 2-го поколения на основе  $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-\delta}$  (YBCO). Это связано с тем фактом, что температура сверхпроводящего перехода напрямую зависит от ионного радиуса редкоземельного элемента [23]. ВТСП ленты 2-го поколения на основе  $\text{GdBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-\delta}$  (GdBCO) ( $\text{Gd}^{3+} = 0.105$  нм) в сравнении с YBCO ( $\text{Y}^{3+} = 0.102$  нм),

<sup>1)</sup>e-mail: degtyarenkopn@gmail.com

имеют более высокую температуру сверхпроводящего перехода  $T_c \sim 93$  К, для YBCO  $T_c = 88\text{--}89$  К, а также демонстрируют оптимальные характеристики при азотной температуре  $T = 77$  К,  $I_c = 1000$  А в собственном поле,  $I_c = 400$  А при  $B \parallel c = 6$  Тл [24].

Исходя из вышеописанного, целью настоящей работы явилось систематическое исследование влияния избытка Gd на сверхпроводящие свойства ВТСП лент 2-го поколения на основе пленок  $\text{Gd}_{1+x}\text{Ba}_{2-y}\text{Cu}_3\text{O}_{7-\delta}$ . Проведен микроструктурный анализ образцов, изготовлены микромостики для прямых токовых измерений и получены угловые зависимости критического тока в различных магнитных полях. Полученные результаты влияния избытка Gd на сверхпроводящие параметры внесут вклад в промышленную оптимизацию получения ВТСП лент 2-го поколения.

**2. Экспериментальная часть.** Для экспериментальных исследований были использованы образцы ВТСП лент 2-го поколения шириной 12 мм на основе GdBSCO, полученные на производственном оборудовании с промышленными скоростями осаждения.

Сверхпроводящий слой напыляли на подложку из сплава Хастеллой С-276 с буферными подслоями  $\text{LaMnO}_3/\text{IBAD-MgO}/\text{a-Y}_2\text{O}_3/\text{a-Al}_2\text{O}_3$ . Для напыления сверхпроводящего слоя использовался метод импульсного лазерного осаждения (ИЛО). Распыление мишеней с различным избытком Gd относительно стехиометрического состава проводилось при помощи Xe-Cl эксимерного лазера с длиной волны  $\lambda = 308$  нм и энергией импульса около 700 мДж. В зоне осаждения буферная лента-подложка нагревалась путем механического контакта с горячей пластиной из инконеля, температура которой составляла порядка 1000 °С. Скорость протяжки ленты-подложки варьировалась в диапазоне 45–60 м/ч [25]. После осаждения ВТСП пленки были защищены слоем напыленного серебра толщиной 2 мкм. Для получения оптимальных значений по содержанию кислорода был проведен отжиг в атмосфере чистого кислорода. В результате получали образцы ВТСП лент с избытком по Gd: +0 %, +15 %, +30 %, с толщиной СП пленки для каждого из образцов порядка 1.8 мкм.

Исследования методами электронной микроскопии проводили на просвечивающем (растровом) электронном микроскопе (П(Р)ЭМ) Titan 80-300, оснащенном корректором сферических aberrаций пробы в режиме темного поля с использованием высокоуглового кольцевого детектора. Образцы для исследований получали методом сфокусиро-

ванного ионного пучка (ФИП) на сканирующем электронно-ионном микроскопе (РЭИМ) Helios Nanolab 600i.

Транспортные характеристики ВТСП лент 2-го поколения измерялись при помощи прямых сильноточных измерений, а для измерений в сильных магнитных полях были изготовлены микромостики. Для этого с помощью лазерной резки из исходных образцов были вырезаны сначала мостики размером порядка 1000 на 40 мкм, а затем они уменьшались до размеров 150 мкм на 5 мкм с помощью ФИП на РЭИМ Helios Nanolab 660. Фотография одного из получившихся микромостиков представлена на рис. 1. Измерения на микромостиках проводились на установке Cryogenic CFMS (Cryogen Free Measurement System) в полях до 16 Тл при различной ориентации внешнего магнитного поля по отношению к плоскости образца. Определение критического тока осуществлялось транспортным методом по критерию 1 мкВ/см. Температура сверхпроводящего перехода определялась из измеренных температурных зависимостей сопротивления на установке PPMS.

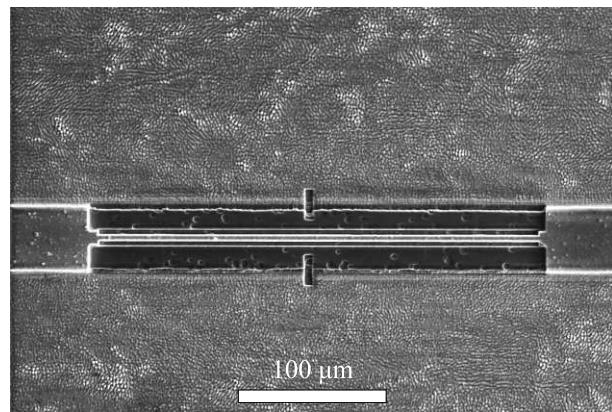


Рис. 1. Фотография мостика образца для измерений на установке CFMS

**3. Результаты и обсуждение.** На темнопольных ПРЭМ изображениях микроструктур (рис. 1а–с) с различным содержанием Gd (+0 %, +15 % +30 %), наблюдаются включения в виде параллельных нитей (скопление точечных дефектов), расположенных вдоль плоскости *ab*. Согласно фазовой диаграмме, представленной в работе [26], эти включения могут являться несверхпроводящей фазой типа  $\text{Gd}_2\text{CuO}_4$ , которая кристаллизуется в направлении (00*l*).

Увеличение избытка Gd приводит к росту количества и характерного размера поперечного сечения этих включений, а также расстояния между ними.

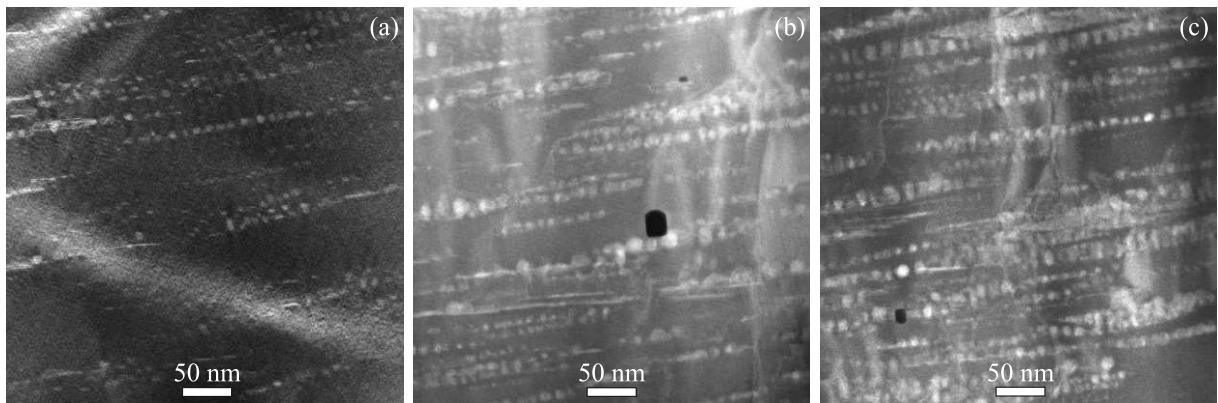


Рис. 2. Темнопольные ПРЭМ изображения микроструктур образцов с различной концентрацией избытка Gd: (а) – +0%; (б) – +15%; (с) – +30%

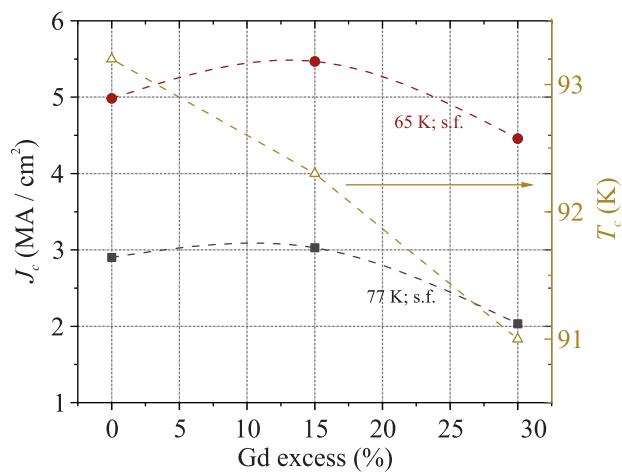


Рис. 3. (Цветной онлайн) Зависимость критического тока и температуры сверхпроводящего перехода в ВТСП – 2 лентах с разным содержанием Gd

Результаты прямых измерений критического тока при 77 К без внешнего магнитного поля для исходных образцов представлены на рис. 3. Наблюдается небольшое увеличение критического тока уже при наличии избытка +15 % Gd, при этом температура сверхпроводящего перехода остается неизменной. Так как длина когерентности при высоких температурах большая и сопоставима по значению с размером наблюдаемых включений, то вихрю легче закрепиться на них. Дальнейшее увеличение избытка Gd до +30 % приводит к падению критического тока как по сравнению со стехиометрическим образцом, так и по сравнению с образцом, где избыток достигает +15 % Gd. В этом случае за счет увеличения концентрации включений происходит уменьшение сверхпроводящих областей, что приводит к уменьшению критического тока. При этом его критическая температура становится ниже на 2 К. Вероятно, паде-

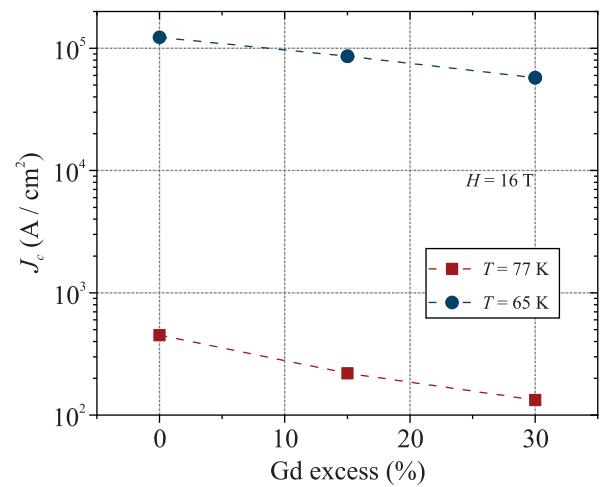


Рис. 4. Зависимость критического тока на 12 мм ленте от стехиометрического состава ленты. Отчетливо видно снижение критического тока при перенасыщении Gd при температуре измерений 77 и 65 К

ние критической температуры свидетельствует о возникновении напряжений на границе СП матрица–несверхпроводящая фаза  $\text{Gd}_2\text{CuO}_4$ , увеличивающиеся с увеличением избытка по Gd.

Характер изменения критического тока в поле 16 Тл при температурах 77 и 65 К представлен на рис. 4. Наблюдаются незначительное монотонное снижение критического тока с увеличением избытка по Gd. По всей видимости, это объясняется тем фактом, что при этих температурах размер образовавшихся дефектов в СП пленке значительно больше вихрей Абрикосова.

Из температурной зависимости продольного удельного сопротивления  $\rho_{ab}$  во внешнем магнитном поле была получена зависимость верхнего критического поля от температуры. Полученная экспе-

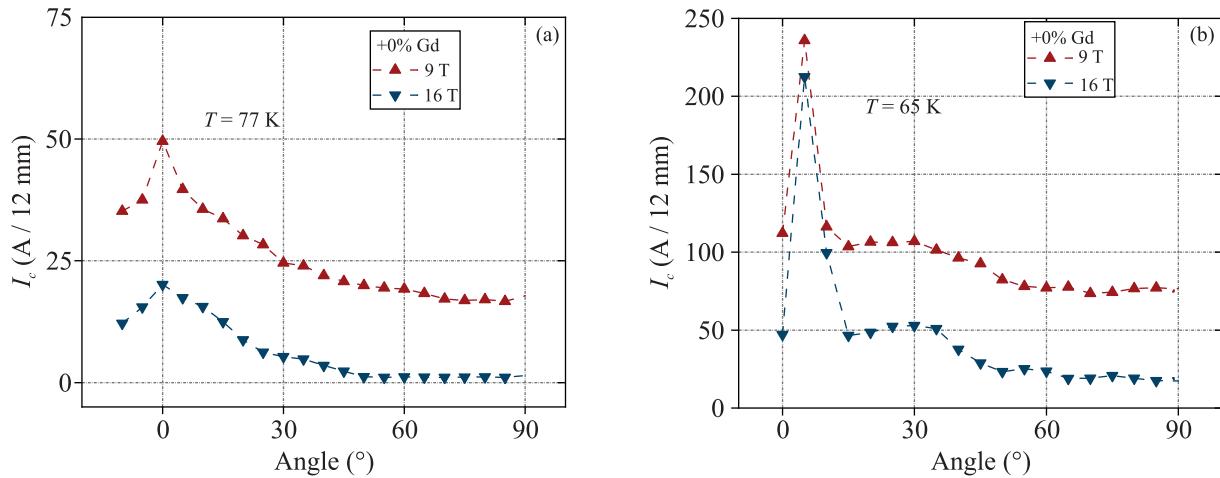


Рис. 5. (Цветной онлайн) Угловые зависимости критического тока образца +0магнитных полях и при температурах 77 К (а) и 65 К (б)

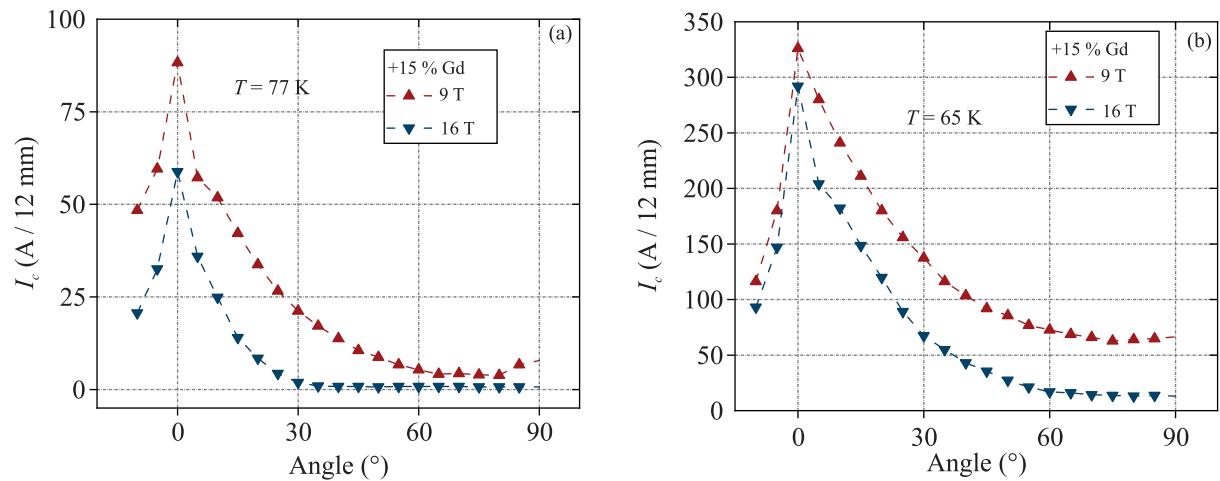


Рис. 6. (Цветной онлайн) Угловые зависимости критического тока образца +15 % Gd в приложенных магнитных полях и при температурах 77 и 65 К

риментальная зависимость была экстраполирована к нулевой температуре по модели Вертхамера–Гельфанд–Хоенберга [27]. По полученным данным было рассчитано верхнее критическое поле в пределе нулевой температуры для трех образцов:  $H_{c2}$  (+0 % Gd) = 48 Тл,  $H_{c2}$  (+15 % Gd) = 33.4 Тл и  $H_{c2}$  (+30 % Gd) = 42 Тл соответственно. Длина когерентности была оценена по формуле Гинзбурга–Ландау [28]. Значения длины когерентности составили для  $\xi$  (+0 % Gd) = 2.59 нм,  $\xi$  (+15 % Gd) = 3.13 нм и  $\xi$  (+30 % Gd) = 2.78 нм. Наблюдается, что с увеличением размеров и концентрации включений, длина когерентности увеличивается по сравнению с исходным образцом.

Далее были проведены измерения профиля критического тока как функция приложенного внешне-

го магнитного поля и его ориентации в конфигурации максимума силы Лоренца, т.е. для случая, когда поле перпендикулярно поверхности образца. На рис. 5 представлены угловые зависимости критического тока для стехиометрического образца. Отчетливо видно отсутствие пика, когда поле параллельно плоскости  $ab$ . Подавление критического тока в пике при 77 К составляет порядка 87 % и при 65 К порядка 95 % в поле 9 Тл по сравнению со значением критического тока в отсутствии внешнего магнитного поля. При 65 К отличие критического тока в полях не так существенно и по сравнению со значением критического тока без внешнего магнитного поля подавляется на 80 %. В случае, когда поле параллельно плоскости образца, для обеих температур и полей деградация критического тока более существенная.

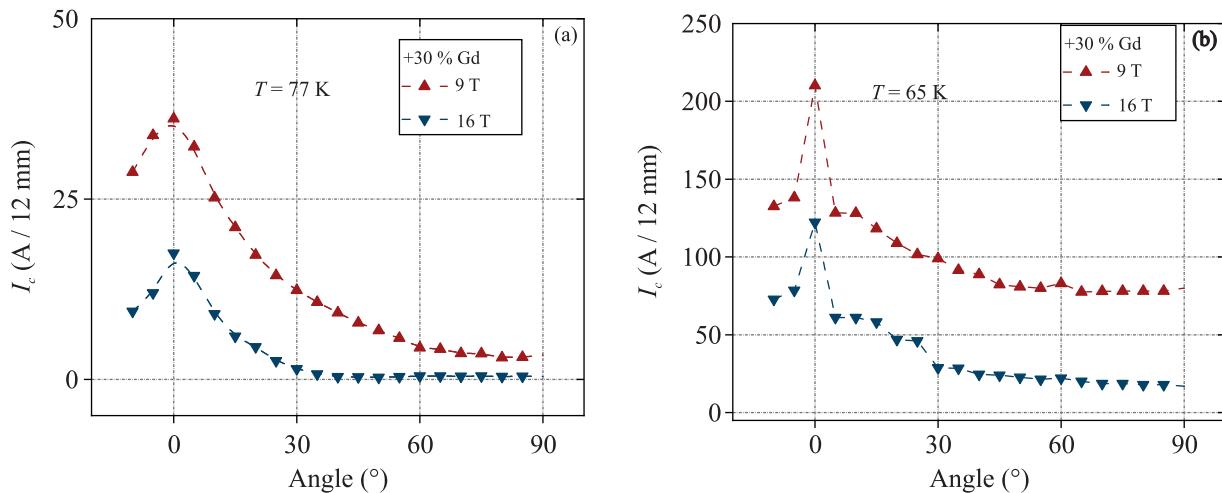


Рис. 7. (Цветной онлайн) Угловые зависимости критического тока образца +30 % Gd в приложенных магнитных полях и при температурах 77 и 65 К

Характер поведения для образца с избытком Gd +15 %, представленный на рис. 6, демонстрирует аналогичное поведение, как и для исходного образца, т.е. пик в случае, когда поле параллельно оси  $c$ , отсутствует при обеих температурах – 77 и 65 К. По всей видимости, такой характер поведения обусловлен тем, что обнаруженные включения  $\text{Gd}_2\text{CuO}_4$  выстраиваются в цепочки вдоль направления плоскости  $ab$ , образуя слоистую структуру (см. рис. 1). При этом стоит отметить, что дефекты имеют не регулярную структуру. Таким образом, вихри пересекают такие дефекты и взаимодействуют с ними как с точечно-подобными дефектами. Образуется большое число слабых связей, что приводит к частичному давлению параметра порядка и, следовательно, падению критической температуры сверхпроводящего перехода.

Для образца с избытком по Gd +30 % (рис. 7) на угловых зависимостях критического тока также не наблюдается пика для случая, когда внешнее магнитное поле параллельно оси  $c$ . В этом образце по данным микроструктурных исследований концентрация включений типа  $\text{Gd}_2\text{CuO}_4$  возрастает по сравнению с образцом с избытком по Gd +15 % (рис. 6). Эти два факта наводят на предположение о том, что образовавшаяся в результате избытка Gd слоистая структура является менее эффективной для пиннинга вихревой решетки. Это также подтверждается более сильным падением критического тока в сильных магнитных полях.

**4. Выводы.** В данной работе были изготовлены образцы ВТСП лент на основе соединения GdBCO с избыточным содержанием Gd, которое достигалось путем внесения изменений в технологический про-

цесс (мишени, режимы). По данным микроструктурного анализа выявлено, что в образцах с избытком Gd присутствуют включения несверхпроводящей фазы типа  $\text{Gd}_2\text{CuO}_4$  в виде слоев, параллельных плоскости  $ab$ . Показано, что 15 %-й избыток Gd приводит к росту критического тока при температурах 77 и 65 К в нулевом внешнем магнитном поле, однако дальнейшее увеличение избытка Gd до 30 % вызывает его уменьшение. При этом температура сверхпроводящего перехода в первом случае не изменяется, а во втором – падает, что может быть связано с изменением напряженности кристаллической решетки [25]. Тем не менее, в поле 16 Тл сильного падения критического тока при избытке Gd +15 % не наблюдается, что, предположительно, связано с изменением типа пиннинга вихревой решетки за счет образования включений фазы  $\text{Gd}_2\text{CuO}_4$ , выступающих в роли дополнительных центров пиннинга вихревой решетки. Обнаружено, что на угловых зависимостях критического тока для образцов с избытком Gd отсутствует явный пик во внешнем магнитном поле, параллельном оси  $c$ , что подтверждает предположение о смене характера пиннинга вихревой решетки вследствие изменения характерных размеров включений. Полученные результаты проведенных исследований могут быть использованы для усовершенствования технологии изготовления ВТСП лент 2-го поколения с более высокой токонесущей способностью.

Магнитные измерения выполнены при поддержке Российского научного фонда № 22-22-00570.

Исследования микроструктуры и анализ полученных результатов выполнены при поддержке Министерства науки и высшего образования (Государственное задание ОИВТ РАН № 075-01129-23-00).

- 
1. D. Uglietti, Supercond. Sci. Technol. **33**, 053001 (2019).
  2. Y. H. Zhou, D. Park, and Y. Iwasa, Nat. Sci. Rev. **10**, 3 (2023).
  3. M. T. Naus, R. W. Heussner, A. A. Squitieri, and D. C. Larbalestier, IEEE Trans. Appl. Supercond. **7**, 1122 (1997).
  4. A. Godeke, M. C. Jewell, C. M. Fischer, A. A. Squitieri, P. J. Lee, and D. C. Larbalestier, J. Appl. Phys. **97**, 9 (2005).
  5. L. Rossi, IEEE Trans. Appl. Supercond. **17**, 1005 (2007).
  6. K. I. Sasaki, T. Nakamoto, N. Kimura, T. Tomaru, T. Ogitsu, N. Higashi, and T. Ichihara, IEEE Trans. Appl. Supercond. **17**, 1083 (2007).
  7. B. Turck, IEEE Trans. Magn. **32**, 2264 (1996).
  8. N. Mitchell, D. Bessette, R. Gallix, C. Jong, J. Knaster, P. Libeyre, C. Sborchia, and F. Simon, IEEE Trans. Appl. Supercond. **18**, 435 (2008).
  9. S. Zhang, S. Xu, Z. Fan, P. Jiang, Z. Han, G. Yang, and Y. Chen, Supercond. Sci. Technol. **31**, 125006 (2018).
  10. G. Blatter, M. V. Feigelman, V. B. Geshkenbein, A. I. Larkin, and V. M. Vinokur, Rev. Mod. Phys. **66**, 1125 (1994).
  11. L. Bottura, S. Prestemon, L. Rossi, and A. V. Zlobin, Front. Phys. **10**, 935196 (2022).
  12. E. Ban, Y. Matsuoka, T. Yoshimura, and K. Takahashi, Thin Solid Films. **338**, 118 (1999).
  13. M. Inoue, S. Nishimura, T. Kuga, M. Kiuchi, T. Kiss, M. Takeo, T. Matsushita, Y. Iijima, K. Kakimoto, T. Saitoh, S. Awaji, K. Watanabe, and Y. Shiohara, Phys. C. Supercond. **372**, 794 (2002).
  14. M. Iwakuma, K. Toyota, M. Nigo, T. Kiss, K. Funaki, Y. Iijima, T. Saitoh, Y. Yamada, and Y. Shiohara, Phys. C. Supercond. **412**, 983 (2004).
  15. V. Chepikov, N. Mineev, P. Degtyarenko, S. Lee, V. Petrykin, A. Ovcharov, A. Vasiliev, A. Kaul, V. Amelichev, A. Kamenev, A. Molodyk, and S. Samoilov, Supercond. Sci. Technol. **30**, 124001 (2017).
  16. S. M. Choi, G. M. Shin, and S. I. Yoo, Phys. C. Supercond. **485**, 154 (2013).
  17. K. Nakashima, N. Chikumoto, A. Ibi, S. Miyata, Y. Yamada, T. Kubo, A. Suzuki, and T. Terai, Phys. C. Supercond. **463**, 665 (2007).
  18. E. Mezzetti, B. Minetti, D. Andreone, R. Cherubini, L. Gherardi, and P. Metra, J. Supercond. **5**, 185 (1992).
  19. D. Huang, H. Gu, H. Shang, T. Li, B. Xie, Q. Zou, D. Chen, W. Chu, and F. Ding, Supercond. Sci. Technol. **34**, 045001 (2021).
  20. T. Matsunami, Y. Ichino, Y. Yoshida, A. Ichinose, and K. Matsumoto, Phys. Proc. **27**, 236 (2012).
  21. M. Miura, M. Yoshizumi, Y. Sutoh, K. Nakaoka, S. Miyata, Y. Yamada, T. Izumi, Y. Shiohara, T. Goto, A. Yoshinaka, and A. Yajima, Phys. C: Supercond. **468**, 15-20, 1643 (2008).
  22. A. A. Abrikosov, Sov. Phys. JETP. **5**, 1174 (1957).
  23. J. G. Lin, C. Y. Huang, Y. Y. Xue, C. W. Chu, X. W. Cao, and J. C. Ho, Phys. Rev. B **51**, 12900 (1995).
  24. A. Molodyk, S. Samoilov, A. Markelov et al. (Collaboration), Sci. Rep. **11**, 2084 (2021).
  25. A. V. Ovcharov, P. N. Degtyarenko, V. N. Chepikov, A. L. Vasiliev, S. Yu. Gavrilkin, I. A. Karateev, A. Yu. Tsvetkov, and A. R. Kaul, Sci. Rep. **9**, 15235 (2019).
  26. O. Y. Gorbenko, S. V. Samoilov, I. E. Graboy, and A. R. Kaul, Chem. Mater. **14**, 4026 (2002).
  27. E. Helfand, and N. R. Werthamer, Phys. Rev. **147**, 288 (1966).
  28. V. L. Ginzburg and L. D. Landau, ZhETF **20**, 1064 (1950).